

## <<电子工艺实用技术手册>>

### 图书基本信息

书名：<<电子工艺实用技术手册>>

13位ISBN编号：9787506658058

10位ISBN编号：7506658054

出版时间：2010-7

出版时间：中国标准出版社

作者：王健石，朱炳林 主编

页数：425

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电子工艺实用技术手册>>

### 内容概要

本手册汇集了电子工艺的实用技术，包括工艺管理与工艺文件、印制电路工艺、表面组装技术、焊接工艺、涂覆工艺及金属覆盖层、防静电技术、热处理工艺、金属制造与锻压工艺、切削加工工艺等，以技术数据、图表等方式全面介绍了电子工艺最常用的标准技术资料，内容全面，资料翔实，实用性强。

本手册可供各类电子工艺人员使用，也可供高等院校电子制造与工艺专业师生参考。

## &lt;&lt;电子工艺实用技术手册&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 工艺管理 1.1 基本要求 1.2 工艺工作程序 1.3 产品设计工艺性审查 1.4 工艺方案设计 1.5 工艺规程设计 1.6 工艺工装设计与制造 1.7 工艺定额编制 1.8 工艺评审 1.9 生产现场工艺管理 1.10 定置管理 1.11 工序质量控制 1.12 工艺纪律管理 1.13 工艺验证 1.14 工艺标准化 参考文献第2章 印制电路板加工工艺 2.1 印制电路板照相底图的技术要求和制作方法 2.2 印制电路板计算机辅助设计光绘照相原版技术条件 2.3 印制电路板生产用照相底版的技术条件和制作方法 2.4 印制电路板图形转移工艺技术要求 2.5 印制电路板孔金属化工艺技术要求 2.6 印制电路板电镀锡铅合金工艺技术要求 2.7 印制电路板酸性光亮镀铜工艺技术要求 2.8 通孔安装焊接组装的要求 2.9 引出端焊接组装的要求 2.10 印制板组装件装联技术要求 2.11 印制电路组件装焊工艺要求 2.12 印制电路组件装焊后的清洗工艺方法 参考文献第3章 表面组装技术 3.1 表面组装电路设计指南 3.2 表面安装焊接组装的要求 3.3 表面安装印制板组装件通用要求 3.4 表面组装工艺通用技术要求 3.5 表面和混合安装印制电路板组装件的高可靠性焊接 3.6 表面组装元器件可焊性试验 3.7 表面组装用胶粘剂通用规范 参考文献第4章 防静电技术和部件三防工艺技术 4.1 电子元器件制造防静电技术要求 4.2 电子设备制造防静电技术要求 4.3 电子产品制造与应用系统防静电测试方法 4.4 印制板组装件保护涂覆准则、分类、材料和典型工艺技术 4.5 浸渍、灌封和绝缘处理工艺技术 4.6 高压部件和器件三防工艺技术 4.7 接插件三防工艺技术 参考文献第5章 机械制造工艺方法分类与代码 5.1 总则 5.2 铸造 5.3 压力加工 5.4 焊接 5.5 切削加工 5.6 特种加工 5.7 热处理 5.8 覆盖层 5.9 装配与包装 5.10 其他工艺方法第6章 金属铸造与锻压工艺 6.1 熔模铸造工艺质量控制 6.2 锻造工艺质量控制要求 6.3 金属板料拉深工艺设计规范 6.4 钢质锻件热锻工艺燃料消耗定额计算方法 参考文献第7章 焊接工艺 7.1 焊缝符号表示法 7.2 激光焊接工艺规程 7.3 电子束焊接工艺规程 7.4 电阻焊焊接工艺规程 7.5 波峰焊接技术要求 参考文献第8章 切削加工工艺 8.1 总则 8.2 车削 8.3 铣削 8.4 刨、插削 8.5 钻削 8.6 镗削 8.7 拉削 8.8 磨削 8.9 齿轮加工 8.10 数控加工 8.11 下料 8.12 划线 8.13 钳工 参考文献第9章 热处理工艺 9.1 热处理工艺材料分类及代号 9.2 热处理质量控制要求 9.3 热处理节能技术导则 9.4 钢件在吸热式气氛中的热处理 9.5 钢件的淬火与回火 9.6 钢件的正火与退火 9.7 不锈钢和耐热钢热处理 参考文献第10章 涂覆工艺及金属覆盖层 10.1 涂料涂覆标记 10.2 涂覆典型工艺 参考文献

<<电子工艺实用技术手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>